

日本信頼性学会誌「信頼性」

Vol.46 No.3 2024.5月号

(通巻277号)

目 次

お知らせ	i
目 次	ix
巻 頭 言		
道具は使い方 松岡 敏成	107
展 望		
「基板実装における信頼性」		
3次元LSIにおける貫通シリコンビア (TSV) に対する故障検査法 王 森レイ, 高橋 寛	108
JTAGテストとHALTによるBGA実装基板の信頼性評価 谷口 正純	116
メモリテストにおけるテストパターン生成に着目したバウンダリスキャンテスト 土屋 秀和, 浅川 毅	122
報 告		
日本信頼性学会 2023年度第1回見学会		
一人間拡張研究センター 高橋 聖	128
日本信頼性学会関西支部 2023年度第1回講演会		
故障物理について (Li電池パック/半導体デバイス) 江上 豊彦	129
日本信頼性学会関西支部 2023年度第2回講演会		
MLCCの故障モードと解析手法 井上 真二	130
日本信頼性学会関西支部 2024年度第1回講演会		
品質・信頼性技術伝承の必要性と課題 松岡 敏成	131
学会情報		
2023年度第6回理事会 (第288回日本信頼性学会理事会) 議事録 総務委員会	132
会員状況	134
編集後記 土屋 秀和	135
広 告		
大同信号株式会社	vii
一般財団法人日本科学技術連盟	viii

The Journal of Reliability Engineering Association of Japan

Vol.46 No.3 May 2024

Content

Preface

How to Use Toshinari MATSUOKA 107

Special Survey

“Reliability for Substrate Mounting”

Test for TSVs under 3D-LSI Senling WANG, Hiroshi TAKAHASHI 108

Reliability Evaluation of BGA Mounted Boards using JTAG Test and HALT

..... Masazumi TANIGUCHI 116

Boundary Scan Tester Focusing on Test Pattern Generation for Memory Testing

..... Hidekazu TSUCHIYA, Takeshi ASAKAWA 122

Report

2023.1st Visiting Report of REAJ Sei TAKAHASHI 128

2023.1st Lecture Report of REAJ Kansai Branch Toyohiko EGAMI 129

2023.2nd Lecture Report of REAJ Kansai Branch Shinji INOUE 130

2024.1st Lecture Report of REAJ Kansai Branch Toshinari MATSUOKA 131

From Editor Hidekazu TSUCHIYA 135

Published by Reliability Engineering Association of Japan